

证券代码：002138

证券简称：顺络电子

深圳顺络电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-023

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 反路演
活动参与人员	2024年8月6日：Franklin Templeton 1人，Point72 4人，Schroders 5人，Millennium 1人，FSSA 1人，国信证券3人，共15人。
时间	2024年8月6日
地点	香港
形式	现场会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：任怡
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司董事会秘书回答投资者提问：</p> <p>1、请分析公司上半年的业绩情况？</p> <p>回答：</p> <p>（1）2024年上半年，通讯及消费电子业务延续了2023年下半年传统旺季的趋势，呈现了淡季不淡的经营结果。通讯业务客户结构进一步优化，客户份额持续提升，新产品如功率电感、高精密电感、LTCC滤波器产品保持高速增长。随着公司产业格局及竞争实力的提升，新产品经营成果正在逐步释放。</p> <p>（2）2024年上半年，汽车电子业务高速增长，信号类变压器产品稳定增长，公司作为电子元器件产品及方案解决提供商，为欧美顶级汽车电子客户持续提供优质的产品与服务。同时，随着汽车电子业务新产品导入进度加速，各类变压器产品迅速放量，拉动国内新能源汽车头部客户份额迅速提升；智能驾驶、智能座舱等车载新应用领域快速发展，推动公司功率电感及共模等产品</p>

	<p>迅速导入新客户。</p> <p>(3) 另外，公司数据中心、光伏储能等新兴市场业务保持了快速增长态势，新产品及新兴市场领域快速发展。公司数据中心目前主要覆盖SSD、DDR5、服务器领域的客户，各品类一体成型功率电感、超大电流功率电感产品导入客户，进展较为顺利。</p> <p>2、公司通常下半年为传统旺季，请问目前看第三季度产能利用率情况如何？</p> <p>回答：</p> <p>(1) 公司目前属于正常旺季状态，产能利用率水平健康。</p> <p>(2) 因公司下游应用领域特性原因，公司正式订单能见度较短，相对于短期订单，公司更加关注行业趋势。</p> <p>3、请问公司在通讯领域的客户进展情况？</p> <p>回答：</p> <p>公司在通讯领域的市场中，保持提升客户份额，拓宽新产品种类的市场策略，新产品在客户中的份额持续提升。</p> <p>随着未来通讯技术产业的新应用推动，预计为元器件带来新的量价增长空间。</p> <p>4、请问公司一体成型功率电感的进展情况？</p> <p>回答：</p> <p>一体成型功率电感是公司重点开发的产品项目，经过公司前期多年持续研发投入，积极与大客户应用项目推动，市场空间持续打开，增长快速，应用市场覆盖面广，市场空间需求量大，未来前景可期。</p> <p>一体成型功率电感属于功率电感大类，在功率电感领域，公司具有业界品类最全、业界领先的设计、制造平台：</p> <p>(1) 叠层平台功率电感适合制造超小、超薄尺寸功</p>
--	---

率电感，主要面向手机、智能穿戴、模块芯片等功率1-10W的应用场景；

(2) 涂覆平台功率电感可制造的产品尺寸、感量范围非常广，性价比高，主要面向手机、家电、安防、车载等功率5-50W的应用场景；

(3) 组装平台功率电感适合制造中大尺寸、大电流功率电感，主要面向服务器、工业等功率50W以上的应用场景；

(4) 模压平台功率电感可制造的产品尺寸、感量范围较广，主要应用于手机、PC、车载、服务器等功率5-2000W的应用场景。其中超低压平台功率电感以其卓越的低损耗、高可靠性优势，在高端消费电子、DDR5、电源模块等领域得到客户青睐；铜磁共烧平台电感凭借领先的高功率密度特性，在AI服务器领域颇受好评。

公司依据细分市场客户及应用，为客户提供全面、系统、性价比高的功率电感解决方案。

5、请问公司在陶瓷品类的进展情况？

回答：

公司的子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司进入精密陶瓷结构件领域多年，产品包括高性能陶瓷材料及制品、结构件陶瓷等，属于平台化研发、定制化产品。目前主要应用市场为智能穿戴、消费电子、新能源、医疗等领域；陶瓷材料拥有优异的材料特性，公司积极布局新应用领域，在新能源汽车、光伏等市场项目推动进展顺利。

公司在精密陶瓷领域经过10余年的精耕细作，已拥有先进完整的粉料制备和制品加工工艺及产线，产品包括氧化锆粉体、氧化锆磨介、手机背板、可穿戴陶瓷外壳、各种类型的氧化锆结构件等。

公司持续投入研究陶瓷粉体技术，积累了丰富的结构陶瓷平台化产品研发技术、新材料应用及制造工艺技术、自动化制造设备等，能够提供多元化产品类别。公司在湘潭的新建工业园已经投产，该工业园为东莞信柏

	<p>结构陶瓷公司配套原材料供应。</p> <p>6、公司近期被国际元器件巨头村田起诉，请问对公司会造成什么影响？</p> <p>回答：</p> <p>公司秉承“遵循标准、科技创新、持续改进，向全球客户提供优异的产品和完善的服务”的经营理念，一贯尊重知识产权，致力于建设自己的知识产权体系，2023年研发投入人民币3.84亿元，相比2022年，增长8.92%。截至2023年12月31日，整个集团拥有已授权有效国内专利930项，其中发明专利365项，实用新型专利553项，外观设计专利12项。</p> <p>公司对原告主张不予认可，正在准备积极应诉。公司产品系列及产品型号众多，本次专利诉讼仅涉及部分产品型号。</p> <p>目前公司的生产经营情况一切正常。</p> <p>7、请介绍公司多产品线的布局战略？</p> <p>回答：</p> <p>(1) 公司属于电子元器件行业，产品线主要布局在磁性器件、微波器件、传感及敏感器件以及精密陶瓷产品四大发展方向。</p> <p>(2) 公司产品广泛应用在通信、消费、汽车电子、工业及控制自动化、数据中心、物联网、新能源及智能家居等领域。</p> <p>(3) 公司在电子元器件领域深耕多年，通过新材料、新技术研究和新产品开发，践行“产品开发、市场开拓双驱动机制”推动公司持续发展。</p> <p>公司的专业精神、技术实力和全球交付能力得到了全球各行业领先企业的广泛认可，并早已成为他们值得信赖的全球合作伙伴。</p> <p>8、请问公司未来的资本市场融资计划？</p> <p>回答：</p>
--	--

公司本身所处行业属于重资本投入行业，每年均有持续扩产需求，对资金要求较高，但公司经营现金流管理良好，流动性充足，目前主要资本支出为新产品扩产及厂房装修等支出，通过负债融资的方式负担。公司信誉良好，银行信用额度充足，且利率保持在较低水平，同时，公司非常重视应收帐款及客户风险控制，拥有较好的偿债能力。

关于资本市场融资方面，后续将根据公司具体投资进度来规划资金需求，制定合适的融资计划，短期内暂不考虑采取资本市场直接融资方案。

9、请问公司对未来的发展规划？

回答：

(1) 电子元器件的市场空间机遇依旧广阔，在全球各行业智慧化大升级的机遇下，电子元器件在向小型化、高功率密度化、低功耗化趋势发展；随着电子行业应用终端向高功能化发展，以及通信方式的高速和大容量化，驱动了电子行业应用终端“信号处理功能”及“电源管理功能”需求持续增长，电子整机中高品质电子元器件使用数量及使用比重持续增加。长期来看，电子元器件行业市场空间广阔，行业成长性趋势明确。

(2) 多元化的产业布局是公司业务全面成长的基础，为实现公司长期稳定发展目标，公司围绕未来长远发展进行布局规划，“培育”未来产业，“布局”新兴市场；“拓展”增量市场，“扩大”存量市场。公司继续围绕元器件领域发力，夯实扩大手机通讯、消费电子等存量市场客户份额及产品种类；开拓推广汽车电子、数据中心、光伏储能等新兴战略市场领域。

(3) 紧抓新兴产业给电子元器件行业带来广阔的发展机会，ChatGPT的横空出世，把AI技术推向了一个崭新高度，AI对千行百业进行变革成为可能。AI时代的到来，为电子整机增加了思考中枢及双眼，使得电子整机具备了强大的数据处理、分析能力和感知能力，提升了电子整机的智能化水平，为电子行业带来了新的市场机

	<p>遇。</p> <p>在产业趋势方面，电子元器件需要满足电子整机提高能源模块转化效率、加快信息交互效率的诉求，超薄、高功率密度、低功耗的磁性器件与高频率、小型化的射频器件将在AI时代大有所为。</p> <p>（4）聚焦基础技术研究，助力公司可持续发展，公司秉承可持续发展理念，持续加大研发投入，长期坚持底层基础技术研究，重视材料、工艺、装备、设计与测量技术的不断升级。</p> <p>围绕磁性器件、敏感及传感器件、微波器件和精密陶瓷四大类产业方向，公司坚持持续创新，开拓技术平台，在关键技术层面保持世界领先水平，实现局部技术创新突破引领行业，创造公司核心技术竞争力。</p> <p>公司致力于实现“成为电子元器件领域专家”的企业愿景，秉持为客户创造价值，为员工提供机会，为股东增加财富，为社会承担责任的发展理念。随着公司布局的产业及规划逐步成长，公司将走向更长远的远期目标。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及应披露重大信息</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>